

請求の範囲

- [請求項1] A I 又は A I 合金からなり、ワイヤ軸に垂直方向の断面における平均結晶粒径が $0.01 \sim 50 \mu\text{m}$ であり、ワイヤ軸に垂直方向の断面に対して結晶方位を測定した結果において、ワイヤ長手方向の結晶方位のうち、ワイヤ長手方向に対して角度差が 15° 以下である結晶方位 $\langle 111 \rangle$ の方位比率が $30 \sim 90\%$ であることを特徴とする A I ボンディングワイヤ。
- [請求項2] ワイヤの硬度が Hv で $20 \sim 40$ であることを特徴とする請求項 1 に記載の A I ボンディングワイヤ。
- [請求項3] ワイヤ線径が $50 \sim 600 \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の A I ボンディングワイヤ。